

74310 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka
prof. Eero Ristolainen

TENTTI 4.3.2002

Kirjallisuuden käyttö kielletty

1. Kerro lyhyesti mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan ja mahdolliset sovellutuskohteet (yht. 6 p):
 - a) COB
 - b) MCM
 - c) BGA
2. CSP-tekniikka? (6 p)
3. Anisotrooppisesti sähköäjohtavien liimojen käyttö flip chip -liittämisessä. (6 p)
4. Lämmönhallinta elektroniikkakokoonpanossa. (6 p)
5. Mitä vaatimuksia optoelektroniikka asettaa elektroniikan pakkaukselle? (6 p)